

一般社団法人 半導体産業人協会
理事長 野澤滋為
講演企画委員長 有門 経敏

2023年8月度 Web版 SSIS フォーラム開催案内

平素、半導体産業人協会の活動に格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

2023年8月度東京工業大学教授・本村真人様をお招きし、新聞でも話題になっている量子センサについてご講演をいただきます。皆様の積極的なご参加をお願い申し上げます。

<講演タイトル>

『動的再構成プロセッサの研究開発と事業化及び AI 分野への展開』

<講師>

東京工業大学 教授 本村真人氏



<御略歴>

87年京都大学修士(物理学)、96年同博士(工学)、87年より NEC にてリコンフィギュラブルハードウェア、マルチプロセッサ等の研究開発に従事。92年 MIT 研究員、2011年より北海道大学教授、19年より東工大教授。人工知能処理アーキテクチャの研究等に従事。92年 IEEE JSSC 年間最優秀論文賞、99年情報処理学会論文賞、11年電子情報通信学会業績賞、22年 市村学術賞功績賞、山崎貞一賞を各受賞。IEEE Fellow。

<講演要旨>

講演者らは、2000年前後に独自の柔らかいハードウェア技術・動的再構成プロセッサ(Dynamically Reconfigurable Processor, DRP)を創出して2010年前後以降様々な機器での実用化に結び付けてきた。また、AI時代に向けて、2010年代後半から様々なAIハードウェアの研究成果を創出するとともに、DRP-AIへと研究展開・事業展開してきた。本講演では、これらの内容について、その時々の状況を振り返りながら、日本の産学における新規技術の研究開発とその事業化の一事例としてお話しする。

<開催要領>

1. 日時 2023年8月7日(月) 15時~17時
2. 形式 オンライン (Cisco社製 Webexを使用)

3. 参加費 会員（個人会員、賛助会員、準会員）：無料
一般：3,000 円（消費税込み）
4. 締め切り 7月28日（金）17時
ただし、150名に達した時点で締め切らせていただきます。
5. 参加申し込み法と Web 版 SSIS フォーラム参加法
- (1) メールタイトルに「**2023年8月度 SSIS フォーラム参加申し込み**」とご記載ください。
 - (2) メール文に、ご氏名、ご所属、メールアドレス、**会員、または一般**、をご記載ください。
 - (3) 半導体産業人協会・講演企画委員会宛（下記アドレス）にメールにて申し込み下さい。
ssforum@ssis.or.jp
なお、事務局ではフォーラムの受付をしておりませんので、ご注意ください。
 - (4) 一般の方への受付確認メールに半導体産業人協会の銀行口座番号を記載します。
口座に**参加費 3,000 円（消費税込み）**をお振込みください（振込手数料は申込者負担）。お振込み後はキャンセルできません。
 - (5) 一般の方も、当協会にご入会いただくと、2022年度会費無料で会員に登録できます。その場合は本フォーラムにも無料参加できます。下記サイトからご入会下さい。
<https://www.ssis.or.jp>
個人会員、準会員入会のご案内 | 一般社団法人半導体産業人協会 (ssis.or.jp)
ご質問がある場合、ssforum@ssis.or.jp 宛にメールでお問い合わせをお願いします。SSIS フォーラムの情報、協会の活動の最新情報は、ホームページでもご覧いただけます。
 - (6) Webex を初めて利用される場合、下記の接続手順を参考にして下さい。
<https://help.webex.com/ja-jp/n665eiq/Join-a-Cisco-Webex-Meeting-for-the-First-Time-as-a-Guest>
また、Webex のさらに詳しい利用方法については、下記の「使い方ガイド」をご一読下さい。
https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/solutions/webex/how-to-use.html

一般社団法人 半導体産業人協会

<http://www.ssis.or.jp>

TEL : 03-6457-3245

FAX : 03-6457-3246
